. EPROYTE (1)

# **EUROPEAN PATENT OFFICE**

### Patent Abstracts of Japan

**PUBLICATION NUMBER** 

05122886

PUBLICATION DATE

18-05-93

APPLICATION DATE

29-10-91

APPLICATION NUMBER

03311696

APPLICANT: NIPPON DENSAN CORP:

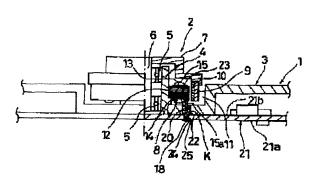
INVENTOR: CHUDA MASANOBU;

INT.CL.

: H02K 5/22 H02K 3/50 H02K 21/22

TITLE

MAGNETIC DISC DRIVING DEVICE



ABSTRACT: PURPOSE: To provide a thin and compact magnetic disc driving device excellent in assembly workability and provided with high quantity.

> CONSTITUTION: A circuit board 21 is provided an the outside of a base 3. A base hole 23 is bored in a corresponding section to a stator of the base 3. A board hole 24 is bored in a corresponding section to the base hole 23 of the circuit board 21. A pin 18 is projected in parallel with the axial center from a stator 8, the lead end 15a of a stator coil 15 is wound on the pin 18 to form a lead terminal 20. The lead terminal 20 is inserted into the base hole 23 and the board hole 24 and is connected to a land section 25 of the circuit board 21 with soldering.

COPYRIGHT: (C)1993,JPO&Japio

(19)日本国特許庁(JP)

## (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-122886

(43)公開日 平成5年(1993)5月18日

(51) Int.Cl.5		識別記号	<b>广内整理番号</b>	FI	技術表示簡所
H02K	5/22		7254-5H		1大州357N <b>国</b> 17[
	3/50	A	7346-5H		
	21/22	M	6435-5H		

### 審査請求 未請求 請求項の数1(全 6 頁)

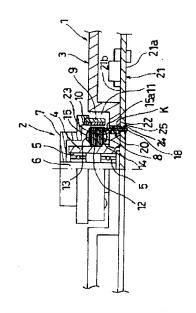
(21)出願番号	特願平3-311696	(71)出願人	000232302
			日本電産株式会社
(22)出願日	平成3年(1991)10月29日		京都府京都市中京区烏丸通御池上ル二条殿
			町552番地
		(72)発明者	
		(12/)0-91 H	***
			鳥取県鳥取市千代水三丁目100番地 鳥取
			日本電産株式会社内
		(72)発明者	忠田 昌僧
			京都府中郡峰山町荒山壱番谷225 日本電
			産株式会社峰山事業所内
		(74)代理人	
		(14)1047	77在工 <b>十七 武嗣</b>

### (54)【発明の名称】 磁気ディスク駆動装置

#### (57)【要約】

【目的】 組立て作業性に優れしかも高品質の薄形・小 形の磁気ディスク駆動装置を提供する。

【構成】 ベース3外部に回路基板21を配設する。ベース3のステータ対応部にベース孔部23を費設する。回路基板21のベース孔部対応部に基板孔部24を貫設する。ピン18をステータ8から軸心と平行方向へ突設し、このピン18にステータコイル15のリード端部15aを巻付けて、リード端子20を形成する。リード端子20を、ベース孔部23及び基板孔部24に挿入して、回路基板21のランド部25にハンダ付けにて接続する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 ベース3外部に回路基板21を配設した磁 気ディスク駆動装置であって、ペース3のステータ対応 部にペース孔部23を貫設すると共に、回路基板21のペー ス孔部対応部に基板孔部24を貫設し、かつ、上記ベース 孔部23及び基板孔部24へ挿入されるピン18を、ステータ 8から軸心と平行方向へ突設すると共に、該ピン18にス テータコイル15のリード端部15aを付着し、リード端子 20を形成し、さらに、上記ベース孔部23及び基板孔部24 に挿入される上記リード端子20を、上記回路基板21のラ 10 【0010】そこで、本発明では、品質を確保すること ンド部25に電気接続したことを特徴とする磁気ディスク 駆動装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は磁気ディスク駆動装置に 関する。

[0002]

【従来の技術】近年、パーソナルコンピュータを始めと する〇A機器は小型化が進み、外部記憶装置の磁気ディ

【0003】しかして、従来の磁気ディスク駆動装置と しては、図10~図12に示すものが知られていた。

【0004】即ち、図10に示す磁気ディスク駆動装置で は、ペースaのモータ外部対応部に、貫孔bを貫設し、 該貫孔bを介してフレキシブルプリント配線cを装置内 部へ侵入させ、このフレキシブルプリント配線cをベー スaの内面側に付設し、そして、モータ内部sからステ ータコイルcのリード端部fを引き出し、このリード端 ンダ付けしていた。

【0005】また、図11に示す磁気ディスク駆動装置で は、モータ内部 s から引き出されたリード端部 f を、コ ネクタgに接続し、このコネクタgの端子hを貫孔bを 介して外部へ突出させ回路部に接続していた。

【0006】さらに、図12に示す磁気ディスク駆動装置 では、モータ近傍においてベースaに貫孔iを貫設し、 この貫孔士を介してフレキシブルプリント配線cを装置 内部に挿入させ、そして、ステータ近傍において、ハン ブルブリント配線cのランド部dに接続していた。な お、ペース3の貫孔b, b, iには、シール材 n が装着 されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】図10に示すものでは、 リード端部 f をモータ内部 s から引き出して、装置内部 のフレキシブルプリント配線 c のランド部 d に接続 (ハ ンダ付け) しなければならず、そのため自動組立てを行 なうことができず、また、リード端部 f は、ロータマグ ネット」と接触する虞れがあり、品質確保が難しかっ 50 と、ステータコア12に嵌込まれる一対のプラスチック製

【0008】また、図11に示すものでは、ステータkか らコネクタgまでの長さ寸法が大で、リード端部 f がべ ースaから浮き上がらないように浮き防止処理を施す必 要があり、しかも、リード端部fが、ロータマグネット **j と接触する虞れもある。** 

【0009】さらに、図12に示すものでは、ハンダ付け スペースは極めて小さく、作業しにくく、また、ハンダ 付け部mがロータマグネット」と接触する虞れもある。

ができかつ組立て作業性に優れた薄形・小形の磁気ディ スク駆動装置を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】上述の目的を達成するた めに、本発明に係る磁気ディスク駆動装置は、ベース外 部に回路基板を配設した磁気ディスク駆動装置であっ て、ベースのステータ対応部にベース孔部を貫設すると 共に、回路基板のベース孔部対応部に基板孔部を貫設 し、かつ、上記ベース孔部及び基板孔部へ挿入されるピ スク駆動装置としても薄形・小型化が図られる傾向にあ 20 ンを、ステータから軸心と平行方向へ突設すると共に、 該ピンにステータコイルのリード端部を付着し、リード 端子を形成し、さらに、上記ペース孔部及び基板孔部に 挿入される上記リード端子を、上記回路基板のランド部 に電気接続したものである。

[0012]

【作用】ステータには、ベース孔部及び基板孔部に挿人 されるリード端子が設けられているので、ステータを組 付けると共に、回路基板のランド部に、リード端子をハ ンダ付けや圧接等によって電気接続すれば、コイルのリ 部 f を、フレキシブルプリント配線 c のランド部 d にハ 30 ード端子を外部へ引き出すことができる。しかも、ピン の位置に対応して回路基板の位置が自動的に決まる。 [0013]

> 【実施例】以下、実施例を示す図面に基づいて本発明を 洋説する。

> 【0014】図1は本発明に係る磁気ディスク装置を示 し、この装置は、フレーム1と、該フレーム1に内装さ れるモータ部2と、を備えている。

【0015】そして、モータ部2は、フレーム1のベー ス3から立設される円筒部4に軸受5,5を介して回転 ダ付けにてステータコイルeのリード端部fをフレキシ 40 自在に枢支されるシャフト6と、該シャフト6に固着さ れる(図示省略の磁気ディスクを搭載する)ハブ7と、 円筒部1に外嵌されるステータ8と、ハブ7にヨーク9 を介して固着されるロータマグネット10と、を備えてい

> 【0016】また、ベース3には、環状に形成された凹 所11が設けられ、この凹所11にモータ部2の一部が侵入 している。これにより磁気ディスク駆動装置の高さ寸法 を減少し、薄型化を図っている。

【0017】しかして、ステータ8は、ステータコア12

のインシュレータ13,14と、ステータコア12及びインシ ュレータ13,14に巻設されるステータコイル15と、を備 えている。

【0018】また、ステータコア12は、下方から見た斜 視図である図2に示すように、薄肉のコアラミネーショ ンが多数積層されてなり、円環基部12a (コアパック 部)とその外周側へ突設したティース部12b…とからな る。

【0019】そして、一方(下方)のインシュレータ14 b…と、円環基部14aの外周縁乃至ティース部14bの内 周縁から突設される突出壁部14cと、を備え、その下面 16の一部に突出部17が設けられ、この突出部17からピン 18が突設されている。

【0020】また、他方(上方)のインシュレータ13 は、図示省略するが、一方のインシュレータ14と同様、 円環基部13aとその外周側へ突設したティース部13b… と、円環基部13aの外周縁乃至ティース部13bの内周縁 から突設される突出瞭部13cと、を備えている。

うに、円環基部13aがステータコア12の円環基部12aの 反ベース部側を被覆し、ティース部13bがステータコア 12のティース部12トの反ベース部側を被覆し、突出壁部 13 c がステータコア12の円環基部12 aの外周面乃至ティ ース部12bの内面の反ベース部側を被覆し、また、イン シュレータ14は、円環基部14 a がステータコア12の円環 基部12aのベース部側を被覆し、ティース部14bがステ ータコア12のティース部12bのベース部側を被覆し、突 出壁部14cが、ステータコア12の円環基部12aの外周面 乃至ティース部12bの内面のベース部側を被覆する。

【0022】また、ピン18は、導体からなり、モータ部 2の軸心と実質上平行方向へ突設されるものであり、図 3に示すように、基部には膨出部19が設けられ、ピン18 の該膨出部19がインシュレータ14の突出部17に埋設され ている。

【0023】そして、ピン18にステータコイル15のリー ド端部15aが巻付けられ、リード端子20が形成される。

【0024】この場合、図4に示すように、リード端部 15 a をピン18の先端まで巻付けなくてもよく、図 5 に示 すように、リード端部15aをピン18の先端まで巻付けて 40 もよい。なお、リード端部15aはピン18に対してハンダ 付けにより固定され、電気接続される。

【0025】しかして、図1におけるベース3の外部に はドライブ回路を構成するための回路基板21が配設され ている。即ち、回路基板21はペース3の凹所11を形成す る壁の外面22に当接した状態で配設されている。

【0026】また、ベース3のステータ対応部には、ベ ース孔部23が貫設され、回路基板21のベース孔部対応部 には基板孔部24が貫設されている。

は同一軸心であり、モータ部2の軸心と実質上平行であ る。また、ベース孔部23は比較的大径とされ、基板孔部 24はピン18より僅かに大きい小径とされる。

【0028】従って、リード端子20は、ベース孔部23及 び基板孔部24へ挿入され、回路基板21から外部へ突出し た突出部が、回路基板21の外面21 a のランド部25にハン ダ付けされる。

【0029】従って、この装置によれば、ステータ8を 組立てた後、該ステータ8を組付ければ、リード端子20 は、円環基部14aとその外周側へ突設したティース部14 10 は図1に示すように、ベース孔部23及び基板孔部24に挿 入され、外部への引き出し可能状態となり、外部からハ ンダ付けすれば、リード端子20の外部引き出し作業が終 了する。また、リード端子20は、ステータ8に対して予 め位置決めされた状態に設けてあるから、回路基板21に 対して容易に挿通できて、かつ誤配線のない電気接続が 可能となる。

【0030】次に、図6は他の実施例を示し、この場 合、ペース3と円筒部4とが一体に形成されたいわゆる ベース一体型モータ部を有する磁気ディスク駆動装置を 【0021】即ち、インシュレータ13は、図3に示すよ 20 示している。その他の構成は図1の場合と同様であるの で、説明を省略する。

> 【0031】また、図7は別の実施例を示し、この場 合、図1と図6に示すモータ部2がシャフト回転型であ るのに対し、シャフト固定型としている。そして、図6 に示した場合と同様にベース一体型モータ部を有する磁 気ディスク駆動装置となっている。これらペース一体型 モータ部の構成により、小型(特に薄型)化と軽量化が 図られ、部品点数が減少し、量産化が容易となる。

【0032】即ち、このモー夕部2は、ペース3の円筒 部26にシャフト27を挿入固着し、該シャフト27に軸受 5,5を介してハブ7を回転自在に枢支し、ベース3の 円筒部26にステータ8を外嵌固着している。

【0033】即ち、この場合も、図1と図6に示すもの と同様、ステータ8には、軸心と実質上平行方向にピン 18が突設され、このピン18にステータコイル15のリード 端部15aが巻付けられ、リード端子20が形成され、ま た、ベース3のステータ対応部にベース孔部23が貫設さ れ、回路基板21のベース孔部対応部には基板孔部24が賃 設されている。

【0034】従って、図1と図7に示すものと同様の作 用効果を奏する。

【0035】しかして、図1と図6と図7に示す磁気デ ィスク駆動装置では、図示省略の磁気ディスクが搭載さ れるディスク室内(図ではベース3の上側)と、ディス ク室外 (図ではベース3の下側) とを封止するため、ベ ース孔部23内には、シール材化が注入される。ベース3 の外面22と、回路基板21の内面21日とが密着するので、 このシール材Kを省略することができる。

【0036】また、シール材Kに代えてベース孔部23内 【0027】即ち、ベース孔部23及び基板孔部24の軸心 50 に接着剤を注入するも同様のシール効果を発揮する。

【0038】次に、図9はさらに別の実施例を示し、こ の場合、ステータコア12のティース部12b、12b間に、 ゴム、軟質プラスチック等の絶縁材からなる介装材29を 介装し、この介装材29からピン18を軸心と実質上平行方 向へ突設している。

【0039】しかして、介装材29は、上壁30を有する円 10 止部37に電気接続状態となる。 筒状体からなり、その孔部31に、ピン18の基端部18 aが 挿入されている。

【0040】また、ピン18は、その先端部が2股状に分 割され、その分割片32、32間の倒立V字状の隙間部33に リード端部15 a の先端が係止している。そして、この係 止した状態で、ランド部25にハンダ付けにてリード端子 20が接続される。

【0041】従って、リード端部15aはピン18に確実に 巻付けられ、よりもどりがないため、このままの状態で 回路基板21へ挿入でき、ランド部25にハンダ付けでき 20 る。この場合は、図1に示した実施例に比べ、リード端 部15aをピン18に対して予めハンダ付けする必要がな く、一層組立て作業性のよいものとなっている。

【0042】なお、介装材29を円筒体とし、ステータコ イルのリード端部15aを、この介装材29の孔部に挿入し て、介装材29の孔部内周面とピン18の基端部外周面とに よりリード端部15aの基端部を挟持させ、リード端部15 aの先端部をピン18に巻付けるようにするも好ましい。 この場合、ピン18の基端に、抜け防止のために、孔部よ り大径の膨出部を設けるも好ましい。

【0043】また、図13に示すように、ピン18として細 長い板片にスリット36を形成した割りピン形状とするも 好ましい。このようにすれば、リード端部15aをスリッ ト36へ滑り込ませれば、ハンダ付けなしで電気接続でき る。即ち、スリット36へ滑り込ませる際にリード端部15 aの絶縁被覆が剥離する(スリ切れる)ためである。

【0044】なお、上述の図1~図5等の実施例におい て、ピン18にリード端部15aを熱溶着(溶接)させるも 望ましい。

【0045】また、ピン18として4角柱等の角ピンとす 40 るも自由である。

【0016】上述の図13の構成や、熱溶着(溶接)又は 角ピンとすれば、ピン18に付着されたリード端部15 a は、よりもどし防止作用を有し、基板孔部24へ容易に挿 入できる。

【0047】なお、本発明は上述の実施例に限定され ず、本発明の要旨を逸脱しない範囲で設計変更自由であ り、例えば、ステータ8のティースの数、コイル15の

数、リード端子20の数も自由に変更することができる。

【0048】また、図6、図7、図8、図9等に示した ハンダ付けを省略して、図14から図15に示すように、回 路基板21のランド部25にリード端子20の先端を、電気接 続しても良い。

【0049】即ち、ピン18の外周面に突出状として、係 止部37と当り部38を、形成し、回路基板21の基板孔部24 へ、図14の矢印方向からピン18を挿入すると、図15のよ うに挟持状に固定される。この状態で、ランド部25が係

[0050]

【発明の効果】本発明は上述の如く構成されているの で、次に記載する効果を奏する。

【0051】① リード端子20を簡単かつ確実に外部へ 引き出すことができ、薄形・小形であっても極めて製造 しやすい。

【0052】② ピン18の位置に対応して回路基板21の 位置が自動的に決まり、組立ての作業性が向上する。

【0053】③ 駆動中に、リード端部15a等がロータ マグネット等に接触することがなく、品質確保を行ない やすく、商品質のものを提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例を示す半截断面図である。

【図2】ステータの要部分解斜視図である。

【図3】ステータの要部拡大断面図である。

【図4】要部拡大断面図である。

【図5】要部拡大断面図である。

【図6】他の実施例の半截断面図である。

【図7】別の実施例の要部断面図である。

【図8】変形例の要部拡大断面図である。 【図9】さらに別の実施例の要部拡大断面図である。

【図10】従来例の半截断面図である。

【図11】他の従来例の要部断面図である。

【図12】別の従来例の要部断面図である。

【図13】ピンの変形例を示す斜視図である。

【図14】電気接続の他の構造を示す説明図である。

【図15】組立て完了状態の同上説明図である。 【符号の説明】

3 ベース

8 ステータ

15 ステータコイル

15a リード端部

18 ピン

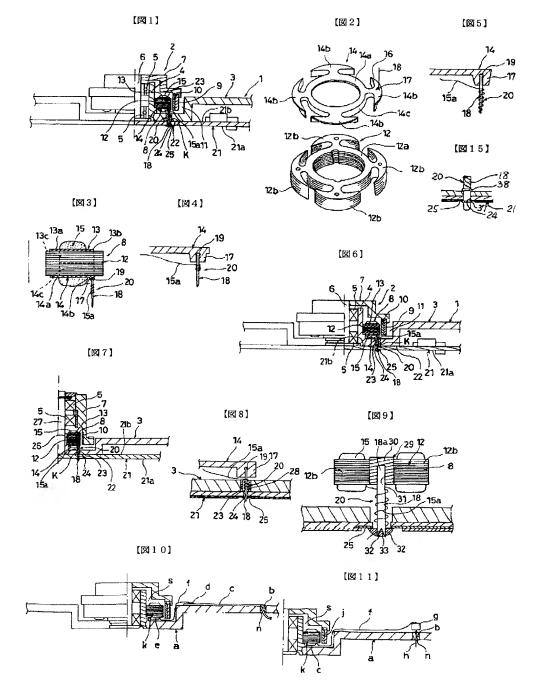
20 リード端子

21 回路基板

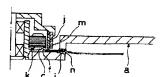
23 ベース孔部

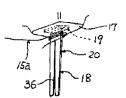
24 基板孔部

25 ランド部



[図12]





[図13]

